

## **P R E S S E M I T T E I L U N G**

### **X-FAB stellt Erweiterung der 0,18-Mikrometer-Technologieplattform für Energieeffiziente Anwendungen vor**

#### ***Neue 60-Volt-Option in Kombination mit eFlash ermöglicht neue Generation von Power-Management-Anwendungen für System-on-Chips zur intelligenten Leistungssteuerung***

**Erfurt – 1. November 2011** – X-FAB Silicon Foundries kündigte heute die neue Technologieplattform XP018 an, ihren jüngsten Foundryprozess mit der weltweit geringsten Maskenanzahl für die modulare Kombination von Digital-, Analog- und Hochvoltfunktionen einschließlich integriertem Flash-Speicher. Dieses einzigartige Foundryangebot ermöglicht es erstmals, die Integration von System-on-Chips (SoCs) mit Betriebsspannungen bis 60V und einer Versorgungsspannung von 5V, mit Hochvoltoptionen (HV) und integrierten nicht-flüchtigen Speicherblöcken zu kombinieren. Damit ermöglicht es eine neue Generation von zuverlässigen und effizienten SoC-Lösungen für Power Management, digitale Steuerung und andere Anwendungen im Bereich Energieverteilung und -überwachung.

Die neue XP018-Prozessplattform bietet Betriebsspannungen von 5V bis 60V sowie einen wettbewerbsfähigen Einschaltwiderstand (RDSon), der kleine Chipgrößen und geringe Kosten ermöglicht. Die einzigartige Kombination von HV und integrierten nichtflüchtigen Speicherelementen erfordert weniger als 30 Masken – die geringste Maskenanzahl der gesamten Foundryindustrie. Der Prozess ist auch bestens für Automobilanwendungen geeignet.

Dazu Rudi de Winter, CEO bei X-FAB: „Die Elektronikindustrie beschäftigt sich zurzeit sehr intensiv mit der Entwicklung energieeffizienter Mikrochips und Systeme. Wir haben die XP018-Technologie entwickelt, um die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden zu adressieren. Für die Entwicklung der nächsten Generation von Power-Management-Anwendungen benötigen sie eine kosteneffiziente Lösung, um intelligente SoCs zu entwerfen, die die 60V-Fähigkeit mit Flash-basierten eingebetteten Mikrocontrollern kombinieren.“

Die Prozesstopologie beinhaltet eine breite Palette von nichtflüchtigen Speicheroptionen einschließlich Poly Fuse zur Schaltkreiskalibrierung (Trimming), OTP, EEPROM und Flash, die alle im Jahr 2012 mit vollständig qualifiziertem Prozess-Design-Kit zur Verfügung stehen werden.

### **Verfügbarkeit**

Die XP018-Technologie ist ab sofort für die Entwicklung und Produktion von Schaltkreisen verfügbar, einschließlich vorab veröffentlichter IP für die Speicheroptionen. Die vollständige Qualifizierung erfolgt 2012.

###

### **Über X-FAB**

Die X-FAB-Gruppe ist die führende analog/mixed-signal Foundry und fertigt im Kundenauftrag Siliziumwafer für analog-digitale integrierte Schaltkreise (mixed-signal ICs). Das Unternehmen verfügt über Waferfabriken in Erfurt und Dresden (Deutschland), Lubbock (Texas, US) und Kuching (Sarawak, Malaysia) und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter weltweit. Die Wafer werden auf der Grundlage hochmoderner modularer CMOS- und BiCMOS-Prozesse in Technologien von 1,0 bis 0,13 Mikrometern gefertigt. Hauptanwendungsgebiete sind der Automobil-, Kommunikations-, Konsumgüter- und Industriebereich. Weitere Informationen unter [www.xfab.com](http://www.xfab.com).

### **X-FAB Pressekontakte**

Thomas Hartung  
VP Marketing  
+49-361-427-6160  
[thomas.hartung@xfab.com](mailto:thomas.hartung@xfab.com)

X-FAB Semiconductor Foundries AG  
Haarbergstr. 67  
99097 Erfurt, Germany  
[www.xfab.com](http://www.xfab.com)

ThinkBold Corporate Communications  
Dagmar Berendes  
+1-408-379-2344  
[dagmar@thinkbold.com](mailto:dagmar@thinkbold.com)

Sarah Miller  
+1-231-264-8636  
[sarah@thinkbold.com](mailto:sarah@thinkbold.com)